



CXP optical cable assemblies from Molex offer improved fiber management for connecting CXP transceivers and complete Molex's iPass+ High-Speed Channel (HSC) CXP Copper and Optical System

Molex's low-profile CXP optical 4.50mm round cable assemblies offer improved fiber management over traditional flat cables for connecting CXP transceivers. The CXP optical cable assemblies utilize 24 fibers using industry-standard MTP/MPO connectors, 12 transmit (TX) and 12 receive (RX), and 10 Gbps high-bandwidth (OM3) fiber. This design meets the InfiniBand bandwidth requirements for CXP modules spaced up to 300.00m (984.25').

Molex provides a complete optical CXP solution with cable assemblies and loopbacks. Products include MTP/MPO-to-LC cable assemblies for connections to Small Form-factor Pluggable (SFP) or LC patch panels. Loopbacks feature a compact housing that loop optical TX to RX ports for testing, burn-in and field troubleshooting.

Features and Benefits

- MTP/MPO CXP connector interface meets CXP interface specifications
- Low-profile, round cable design for improved cable management over flat cable, with 360° cable-routing capability
- Up to 10 Gbps data rate capability provides optimized bandwidth by application
- RoHS compliant to meet environmental requirements for electronic equipment and accessories

Molex's CXP optical cable assemblies are part of the iPass+ HSC CXP system, which is the latest addition to the existing iPass product family. The iPass Interconnect System offers connectors and cables that enable flexible-speed compatibility for applications ranging from 1 to 10 Gbps and is an ideal solution for the growing server-storage market. For additional information, visit: www.molex.com/link/cxp.html.

106284 Cable Assemblies



SPECIFICATIONS

Reference Information

Packaging: Individual pack in a bag
Mates With: CXP Optical Transceivers

Optical

Fiber Specifications:
Fiber Count: 24 fibers (12 TX / 12 RX)
Multi Mode: 50/125µm
Insertion Loss at Test:
Multi Mode: 0.22dB Typical; ≤0.75dB max.
Connector to Connector: MTP to MTP
Bandwidth: See table on page 2 of datasheet

Mechanical

Bend Radius: 50.8mm (2.00") min. long-term

Physical

Jacket Dimensions:
Interconnect Cables – 1 to 20 meters: 4.50mm (.177")
Distribution Cables – 21 to 300 meters: 5.40mm (.213")
Fire Rating:
OFNR (Riser): Lengths less than or equal to 20 meters
OFNP (Plenum): Lengths over 20 meters
Operating Temperature: 0 to +70°C
Storage Temperature: -40 to +70°C

- **High-Performance Computing**
 - Controller cards and servers
 - Switches
 - Direct Attached Storage (DAS)
- **Data Centers**
 - Controller cards and servers
 - Switches
 - Blades
 - Storage Attached Networks (SAN)
- **Networking**
 - NIC cards and servers
 - Switches
 - Routers
 - Network Attached Storage (NAS)



BANDWIDTH SPEEDS

Fiber Type	Overfilled Launch Bandwidth, Min. (MHz-km)		1 Gigabit Ethernet Link Distance, Min. (m)		10 Gigabit Ethernet Link Distance, Min. (m)	
	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm
Standard Bandwidth	500	500	600	600	86	-
High Bandwidth	1500	500	900	550	300	-

ORDERING INFORMATION

Order No.	Bandwidth	Fire Rating	Cable Diameter	Length
106284-0001	Standard	OFNR (Riser)	4.50mm (.177")	1.00m (3.28')
106284-0005				5.00m (16.40')
106284-0010				10.00m (32.81')
106284-0015				15.00m (49.21')
106284-0020				20.00m (65.62')
106284-0025		OFNP (Plenum)	5.40mm (.213")	25.00m (82.02')
106284-0030				30.00m (98.43')
106284-0050				50.00m (164.04')
106284-0100				100.00m (328.08')
106284-1001				High (10 Gbps)
106284-1005	5.00m (16.40')			
106284-1010	10.00m (32.81')			
106284-1015	15.00m (49.21')			
106284-1020	20.00m (65.62')			
106284-1025	OFNP (Plenum)	5.40mm (.213")	25.00m (82.02')	
106284-1030			30.00m (98.43')	
106284-1050			50.00m (164.04')	
106284-1100			100.00m (328.08')	

www.molex.com/link/cxp.html

Americas Headquarters
 Lisle, Illinois 60532 U.S.A.
 1-800-78MOLEX
 amerinfo@molex.com

Asia Pacific North Headquarters
 Yamato, Kanagawa, Japan
 81-46-265-2325
 apninfo@molex.com

Asia Pacific South Headquarters
 Jurong, Singapore
 65-6268-6868
 apsinfo@molex.com

European Headquarters
 Munich, Germany
 49-89-413092-0
 eurinfo@molex.com

Corporate Headquarters
 2222 Wellington Ct.
 Lisle, IL 60532 U.S.A.
 P: 630-969-4550 F: 630-969-1352



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.